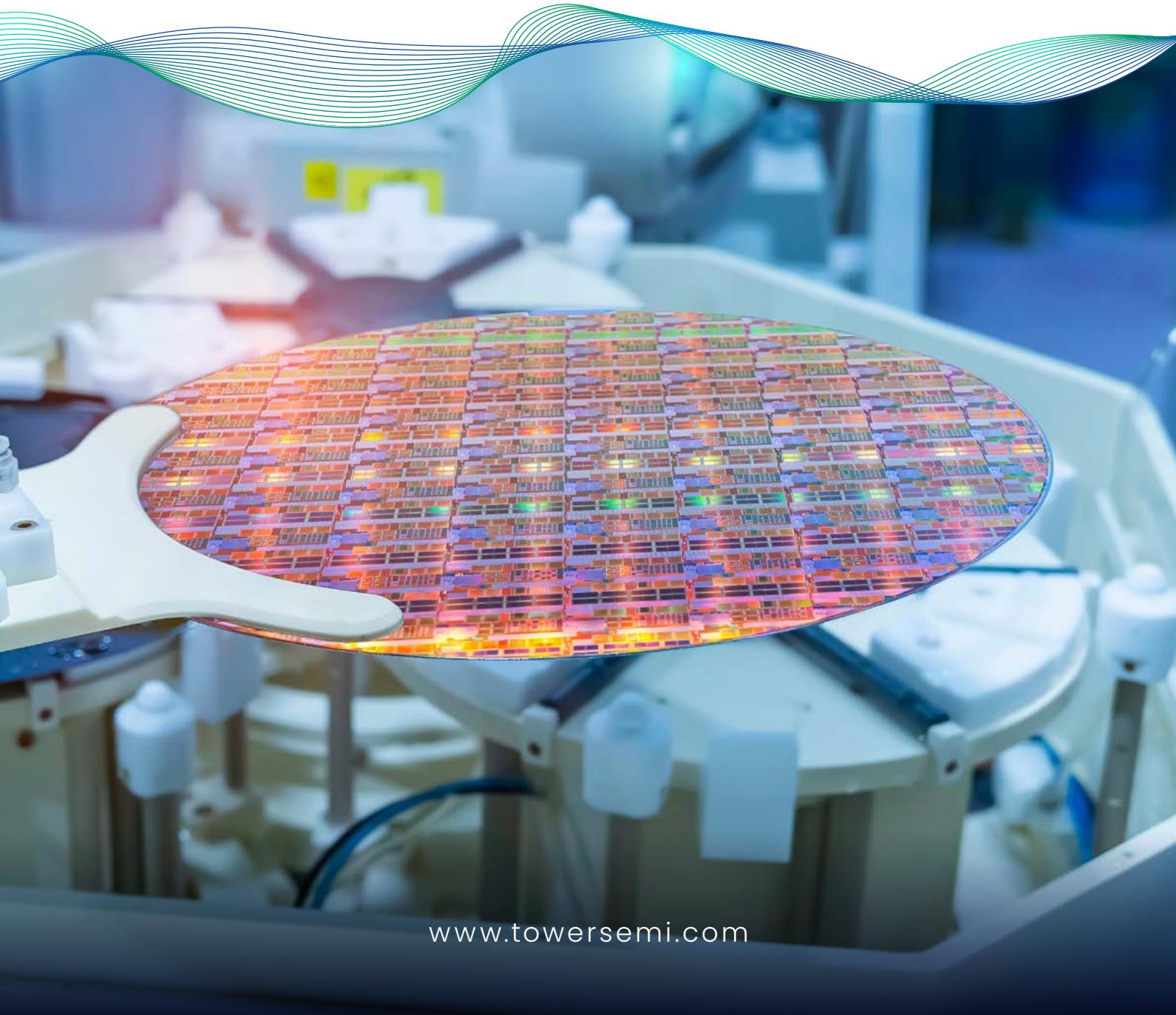


NASDAQ & TASE: TSEM



CORPORATE OVERVIEW



OUR VISION

アナログ半導体において、お客様、社員、株主を始めとする全てのパートナーにとって最も付加価値の高いソリューションを提供します。

OUR MISSION

革新的なアナログテクノロジーとモノづくりのソリューションを通じ、世界にポジティブで持続可能な影響を与え、長きにわたって信頼されるパートナーであり続けます。

OUR VALUE VECTORS



EXCELLENCE

私たちは、すべてのプロセスにおいて最高を目指し、お客様と社員の双方に最良の体験と高い満足感を提供します。卓越性は、「品質」「効率」「有効性」という3つの柱によって支えられており、これらは欠かすことのできない要素です

PARTNERSHIP

私たちは、お客様、社員、株主にとって信頼される長期的なパートナーであり続けます。

IMPACT

持続可能な未来の実現に向けて、社会に価値ある変化をもたらす取り組みを推進します。

LEADERSHIP

活気ある成長市場において、技術とモノづくりを通してリーダーシップを発揮します。

INNOVATION

イノベーションを生む環境の中で、優れたアイデアを価値に変えていきます。

At a Glance...



OUR VALUE

絶対的な信頼と戦略的なお客様のロードマップの策定、そして成功の共有を基盤に最高の価値をもたらすアナログ半導体技術と製造ソリューションを提供していきます。

OUR TECHNOLOGY

私たちは、高品質で革新的な技術ソリューションでアナログエコシステムをリードしています。高周波・高性能アナログ、パワーマネジメント、CMOSイメージセンサ、非イメージセンサ、MEMSなど、幅広い分野でカスタマイズ可能なアナログテクノロジーを提供し、成長市場において強力な競争優位性を実現しています。さらに、多様化し続ける顧客基盤に向けて、最先端かつ革新的な市場ソリューションを展開しています。進化し続ける力と革新的な発想を活かし、強みを発揮できる分野に注力することで、Win-Winの関係を築く差別化されたソリューションを提供し、お客様が市場でリーダーシップを発揮できるよう支援します。

OUR OPERATIONAL CAPABILITIES

世界に複数の製造拠点(200mm、300mm)を展開し、北米・ヨーロッパ・アジアにおいてグローバルな存在感を示しています。世界に広がるデュアル・ソーシング体制と共に、拡大するお客様のご要望に応えながら、生産能力の確保、そして柔軟なオペレーションを実現します。

OUR FINANCE

利益拡大とフリーキャッシュフローの確保に重点を置いた強固な財務基盤とビジネスモデルで、継続的な成長と付加価値の創造を可能にしています。

OUR PEOPLE

世界中で4,500人以上の専門的な知識、豊富な経験、そして高度なスキルを有する従業員が在籍しており、当社の成長と価値創造を支えています。

Our Business Units



高周波&高性能アナログ

高速通信の未来を支える技術

当社は、データ通信、通信、ネットワークアプリケーション向けに、無線RF、ミリ波(mmWave)、高速光通信を網羅する業界最先端の低損失・高ダイナミックレンジテクノロジーを提供しています。当社の先進的なシリコンフォトニクス(SiPho)、シリコンゲルマニウム(SiGe) BiCMOS、RF-SOI、RF-CMOSプラットフォームは、AI、データセンター、量子コンピューティング、モバイル、自動車、インフラ、コンシューマー市場など、幅広い分野で、高速、低ノイズ、エネルギー効率の高いソリューションを実現します。



パワーマネジメント

効率を高め、未来を形づくる

当社のパワーマネジメントプラットフォームは、業界をリードする高度なモジュール化BCD技術を採用し、幅広い電圧範囲においてクラス最高の効率を実現します。モバイル、コンシューマー、産業、データセンター、インフラ、車載、医療用などの様々な用途に対応する包括的なソリューションを提供し、高集積化、省スペース設計、そして高い信頼性を実現します。



センサ&ディスプレイ

よりスマートな未来を実現するセンシング&イメージングプラットフォーム

当社は、業界をリードするイメージング、ディスプレイ、そして非イメージングセンサ(non-Imaging Sensor)技術を、高性能でカスタマイズ可能なプラットフォーム上で展開しており、様々な用途に対応可能です。当社のCISソリューションは、車載、医療、マシンビジョン、AR/VR向けの高度なピクセル設計を特徴としています。また、高解像度のマイクロディスプレイや放射線、温度、磁気、紫外線、ガス検知非イメージングセンサにも対応しており、多様なスマートセンシングアプリケーションに対応しています。



車載用途

よりスマートなクルマを実現する革新的なアナログソリューション

当社は、センサやディスプレイ、無線／有線通信、ミックスドシグナル、パワーマネジメント向けに、成熟したモジュール型アナログ技術プラットフォームを幅広く展開しています。これにより、電動・自動運転車向けに最も包括的かつ先進的なソリューションを提供しています。



航空宇宙・防衛分野

航空宇宙・防衛向け戦略的ファンドリサービス

当社は、航空宇宙および防衛分野の用途に対応する包括的なアナログ技術ソリューションを提供しています。光通信、レーダー、イメージング、センシングを支える技術を、ITAR認証を取得した米国内の信頼性の高い製造体制と専任サポートによりご提供します。

グローバルに展開する卓越したオペレーション体制

私たちは、イスラエル、ヨーロッパ、米国、日本などの複数のグローバル拠点を通じて、高品質かつ柔軟なオペレーションを実現し、生産能力の増強と地理的多様化を目指すファブレス企業やIDM（垂直統合型デバイスメーカー）に高品質かつ柔軟な供給体制を提供しています。

私たちは、あらゆる面において卓越性を追求し、日々オペレーションパフォーマンスの向上に努めています。独自の高性能アナログ技術を提供するリーディングファンドリとしての確固たる評価と、市場ニーズに即した事業戦略とともに、世界各地の製造拠点への賢明な投資を続けることで、進化し続けるお客様のニーズと高まる需要に最大限にお応えします。

8", 200mm

Migdal Haemek, Israel



- Sensors, Power, RF SOI, SiGe
- 0.18µm to 0.13µm

8", 200mm

Newport Beach, CA, USA



- SiGe, MEMS, RF SOI, SiPho
- 0.18µm to 0.13µm

8", 200mm

San Antonio, TX, USA



- RF SOI, Power, SiGe, SiPho
- 0.18µm

8", 200mm

Tonami, Japan



- Power Discrete
- 0.18µm

12", 300mm

Uozu, Japan



- Power, Sensors, RF SOI, SiGe, SiPho
- 65nm & 45nm

12", 300mm

Agrate, Italy



- Analog RF SOI
- 65nm

*ST's Fab

12", 300mm

Rio Rancho, NM, USA



- Power BCD

*Intel's Fab



デザインイネーブルメント

革新を支える設計支援プラットフォーム

当社の差別化されたデザインイネーブルメントプラットフォームは、堅牢な設計工場システムをお客様に提供します。これを当社の先進的なアナログ技術と組み合わせることで、製品ごとの最適化を最大限に引き出し、お客様の革新的なアイデアを具体的な価値へつなげることを可能にし、その成果はお客様と当社双方にとっての成功を生み出しています。

当社のデザインイネーブルメントプラットホームの特長は、経験豊富で高い専門スキルを持つ設計エンジニアで構成された「デザインセンター」の存在です。専用のデザインセンターを持つことで、イノベーションを加速し、設計と製造のシームレスな連携を実現します。これにより、製品の性能、電力効率、チップ面積に合わせてお客様の製品を最適化することを可能になります。

当社は、高精度な電子設計自動化(EDA)ツールと設計IPを提供するとともに、世界中の設計支援チームによるカスタマイズ設計支援も提供しています。これにより、コネクティビティ、コンシューマー、産業、車載など多様な市場で求められるスマートICの高度な要件に対応し、初回シリコンからの動作成功を目指した効果的かつ成功率の高い設計サイクルを実現します。

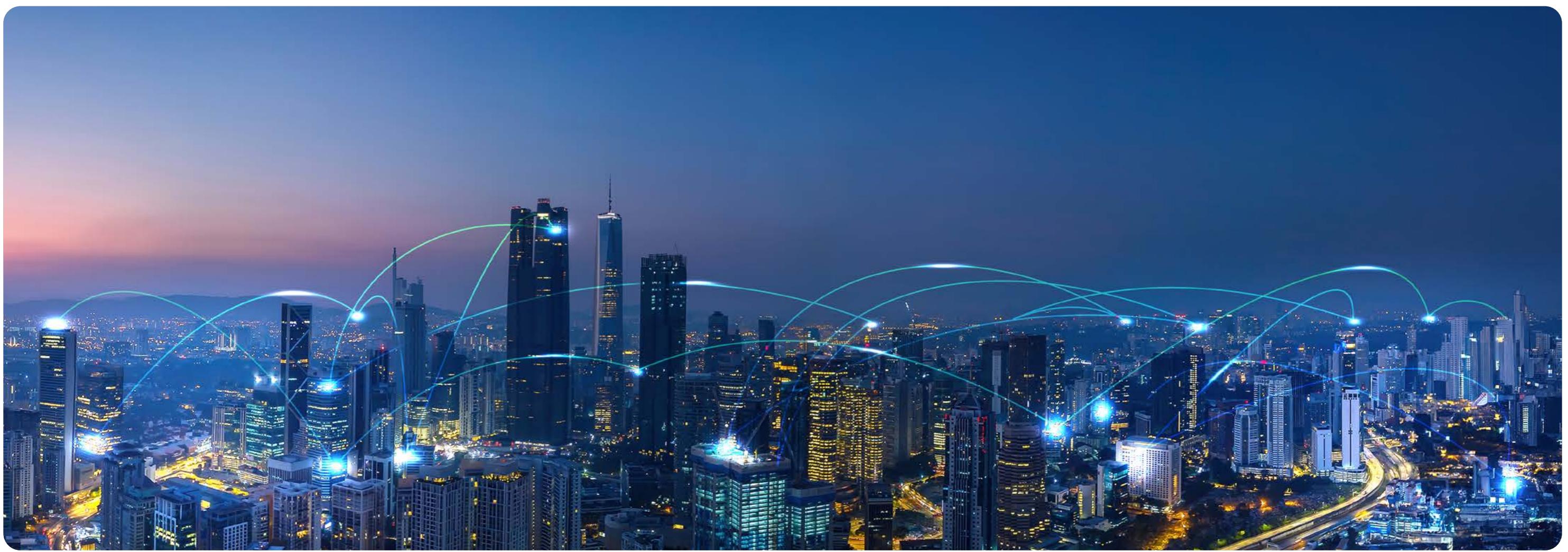
また、世界の主要なEDA、IPベンダーと設計パートナーとの長期的な連携を通じて、ファブレス企業の設計チームが製品性能を最大限に引き出し、市場投入までの時間を短縮することができる、用途に即した差別化された設計機能を提供します。

私たちは、進化する市場ニーズに対応するために、設計サービス、ツール、サポート体制のさらなる拡充に継続的に取り組み、最先端のソリューションとサービスをお客様に提供することで、イノベーションと高性能化を推進しながら、次世代ICの設計を成功に導きます。



世界規模のデザインセンター (イスラエル、ナタニヤ)

当社の世界クラスのグローバルデザインセンターは、最先端の設計ツール、IP (設計資産)、そして専門的なサポートを通じて、お客様が「初回シリコンでの成功 (First-Time-Right)」を実現し、市場投入までの時間を短縮しながら、製品性能を最大限に引き出せるように支援しています。



高周波&高性能アナログ

業界をリードする無線・有線通信向けの豊富な技術ポートフォリオを提供し、世界各地に製造拠点を展開しており、柔軟な生産能力と事業継続性を確保しています。

モバイル通信向けRF技術

タワーの先進的なRFプラットフォーム技術(RF SOIおよびRF SiGe)は、モバイル機器や通信インフラからミリ波、さらにはその先の戦略的アプリケーションに至るまで、性能を最適化したソリューションを可能にし、次世代通信に不可欠な広帯域化、高集積化、電力効率の向上を実現します。

RF SOI(シリコン・オン・インシレーター)

タワーのRF SOI技術は、極めて低いRon-Coff性能指数と高出力という特性をそなえているため、低挿入損失、高リニアリティのRFスイッチ、アンテナチューナー、低ノイズアンプの実現を可能にします。増え続けるデータレートと低消費電力をサポートするクラス最高のパフォーマンスを提供してきた実績により、タワーはAI対応次世代スマートフォンの多様なニーズに応える準備が整っています。

RF SiGe(シリコンゲルマニウム)

SiGe技術は、優れた雑音指数とリニアリティを持ち、セルラー、GPS、衛星受信機などの高性能な低ノイズアプリケーションに最適です。また、III-V族材料に比べて費用対効果が高いSiGeは、新しい通信デバイスを普及させるWi-Fi、Bluetooth、IoTなどの低電力パワー・増幅器にも理想的です。またこの技術は、優れた高周波性能により、車載レーダや衛星通信などのミリ波アプリケーションに最適で、すでに幅広く活用されています。

光インフラを支える高性能アナログ技術

私たちは、AIクラスターとクラウドコンピューティング市場の急速な成長を支えるSiGe(シリコンゲルマニウム)およびSiPho(シリコンフォトニクス)技術の分野で世界的なリーダーとして評価されています。当社のSiGeプラットフォームは、最大800Gb/sに対応する現行の大容量データ通信だけでなく、1.6Tb/s超の次世代アプリケーションにも対応可能な帯域幅と品質を提供できるよう設計されています。また、当社のSiPho技術は、業界初のオープンファンドリSiPhoプラットフォームの一つとして開発され、現在も数少ないオープンなSiPho技術として業界を牽引しています。これらのSiGeおよびSiPho技術は、次世代AIに必要な最高レベルのパフォーマンスを提供するために、スケールアップとスケールアウトの両方の接続性をサポートし、今日のグローバル光通信インフラの中核を担っています。

高性能SiGe(シリコンゲルマニウム)技術

300GHzを超える優れたトランジスタ速度を実現し、データレートが増加し続ける各世代の光トランシーバーで使用されるリニアドライバ、TIA、アナログリドライバ/リタイマなどの重要な電子部品に対応しています。私たちは業界のリーダーと連携し、次に求められる技術を見据えたロードマップを策定し、最適なタイミングで最適なアプリケーションに対応できる技術を提供しています。

シリコンフォトニクス(SiPho)技術

タワーの量産対応SiPhoプラットフォームは、オンチップ光検出器、導波路、高速変調器を備え、従来のディスクリート部品を置き換えることで、小型化、省電力、低コスト設計を可能にします。レーザーなどのIII-V族コンポーネントにも対応可能な高度な統合技術により、サプライチェーンを簡素化し、スケーラビリティの向上を可能にします。タワーのSiPho技術は、100Gb/波長から400Gb/波長へと進化を続ける高速通信ニーズに対応し、Pluggable、near-package optics:NPO、co-packaged optics:CPOまで、あらゆるフォーマットで次世代の光接続を支えています。



パワーマネジメント

当社の業界をリードするパワーマネジメント技術は、モジュール式BCDプラットフォームを基盤に、幅広い電圧や絶縁要件に対応し、モバイル、コンシューマー、データセンター、インフラ、車載、医療向けなどの様々な分野においてクラス最高の電力効率を提供します。

65nm BCD

当社の65nm BCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)技術は、3.3V～24Vの動作範囲に対応し、電力IC市場の大部分をカバーしています。超低抵抗のLDMOSデバイスにより、マスク数の削減と小型ダイサイズを実現し、最高レベルの電力効率、優れたデジタル集積性、そしてコスト競争力を提供します。このプラットフォームは、モバイル向けPMIC、オーディオアンプ、ロードスイッチ、DC-DCコンバータ、LEDドライバ、モータードライバ、バッテリー充電IC、アナログ/デジタルコントローラなど、さまざまな製品において強力な競争力を発揮します。

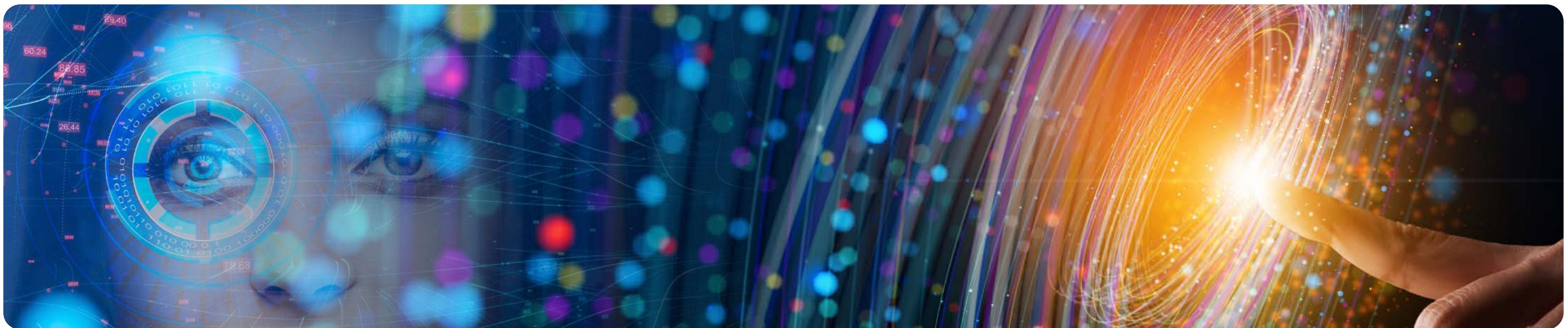
当社は、お客様の進化するニーズに応えるため、中電圧帯の機能拡張を進めています。

65nm BCDプロセスには、5Vおよび3.3Vのゲート酸化膜オプションがあり、リチウムイオンバッテリー駆動機器やサーバー電源など、厳しい要件にも対応可能です。さらに、フルセットのデジタル標準セルライブラリと多様な不揮発性メモリオプションを備えており、理想的なパワーマネジメントソリューションを実現します。

180nm BCD

当社の200mm BCDテクノロジーは、12Vから200Vまでの幅広い動作電圧に対応し、コンシューマー、産業機器、車載(パワートレインの電動化、モーター制御、LED照明およびLiDAR用ドライバ)など様々な分野の市場に最適な電力性能を提供します。クラス最高性能のオン抵抗と多様な絶縁方式により、用途に応じた最適化が可能です。特に48Vシステム向けに高度に最適化されたデバイスは、製品の小型化と部品コストの削減に大きく貢献します。

LDMOS性能の継続的な改良により、当社はお客様が業界をリードする電力変換効率の高いソリューションを開発できるよう支援しています。



センサ&ディスプレイ

お客様のニーズに合わせた、最先端のイメージングおよびセンシングソリューションを提供します

CMOSイメージセンサ

先端画像アプリケーションのための高性能ピクセル技術

最適化されたピクセル技術、卓越した製品品質、設計の柔軟性と幅広いサポート体制を備えた独自のプロセスと確立されたCMOSイメージセンサ(CIS)技術により、最先端市場や多様なアプリケーションへの道を拓きます。仕様に合わせたピクセル設計と社内で培った専門的技術に基づく豊富なノウハウにより、競争力の高い先進機能を備えた優位性のあるプラットフォームを提供し続けています。

私たちのイメージセンサ部門は、さまざまな市場分野に対応しています。

長年にわたって取り組んできた分野には、ハイエンド写真撮影(受賞歴のある映画撮影用カメラや放送用カメラを含む)、産業用・マシンビジョン、医療・歯科用の大型X線センサーなどがある他、自動車分野、モバイル機器、3Dセンサといった急成長中の市場にも対応しています。

また、世界をリードするグローバルシャッター(GS)ピクセル技術と先進的なハイブリッドボンディング裏面照射(BSI)ウェハ技術を提供し、世界の進化する市場ニーズに応える革新的な製品開発を可能にする高度な機能を提供しています。

長年にわたり、お客様からの要求仕様に基づいたピクセル設計とシリコン実装に多大な投資を行っており、これにより技術的な優位性を確立し、新たなビジネス成長の機会を切り拓いています。

マイクロディスプレイ

AR/VRにおけるリアルな映像体験をもたらす技術

タワーセミコンダクターは、長年にわたる大規模かつ高歩留まりのイメージセンサ開発の実績を活かし、マイクロディスプレイ分野にも技術を展開しています。高輝度・低リーク特性を備えたマイクロOLEDディスプレイ向けに最適化された専用プロセスを開発し、市場ニーズに応じた複数拠点での製造体制を整えています。

65nm高電圧CMOS技術は、高精細かつ大型(1.4インチ以上)のAR/VR・XR向け2チップソリューションにおいて、特に高い価値を発揮しています。

また、ピクセルピッチの小さいマイクロOLEDディスプレイ用バックプレーン向けに、超高画素密度を実現する先進的な素子開発を進めており、専用プロセスの継続的な開発と改良により、高歩留まりな製造を実現しています。さらに、急成長を続けるVR市場に向けて、大型シリコン基板に対応したスティッチング技術を含むLCOSディスプレイ用バックプレーン技術も提供しています。

非イメージングセンサ

より環境にやさしく安全な世界の実現に向け、グローバルな環境課題に対応する革新的なセンシングソリューションを開発

当社は、イオン化放射線(X線・ラドンを含む)センサ、遠隔温度センサ、磁気センサ(TMR)、紫外線センサ、ガスセンサなど、多様なセンシングデバイスの製造を可能にする技術プラットフォームを提供しています。高度な実績と柔軟な対応力を備えたこれらの技術は、現代の「つながる社会」において需要の高い高機能センサの実装を可能にします。成熟したプロセス技術と革新手法により、センシング領域における多様なソリューションを開発・提供・支援しています。

当社は、以下のような多様なセンシングデバイスの製造を可能にする技術プラットフォームを提供しています。

- **遠隔温度センサ**: 広範な温度領域にわたり高感度かつ高精度を実現。モバイル機器、IoT、産業機器、自動車、医療機器、セキュリティ分野に対応。
- **時間-温度インジケータセンサ**: 電源不要で再利用可能なCMOS埋め込み型センサ。食品、農業、医療、製薬分野に最適。
- **フローティングゲート放射線センサ**: 電源・シンチレータ不要で再利用可能なセンサ。放射線モニタ、バッジ型線量計、滅菌装置、ラドン検出器などに活用。
- **磁気センサ**: 高感度トンネル磁気抵抗(TMR)型センサにより磁場強度を高精度に検出。産業用、自動車用、民生用、宇宙関連機器に対応。
- **UVセンサ**: 太陽光を遮断する設計と高感度、高温動作が特長。皮膚保護、炎診断、自由空間光通信、滅菌、産業オートメーションなどに最適。
- **ガス・湿度センサ**: 高温動作、容易かつ迅速なリセット、多種ガス対応のセンサフュージョン機能を備え、自動車、産業、医療、環境分野の用途に対応。

これらすべてのセンサ技術は、当社独自のプラットフォーム上に構築されています。たとえば、組み込み型不揮発性フローティングゲート技術やMEMSベースの膜構造などにより、フルセンサオンチップ設計を可能にする内製の回路設計技術を活用しています。

とりわけ、当社の水素センサ技術は、バッテリーの健全性モニタリングや水素エネルギーECOシステムに対応する先進的なソリッドステートセンサとして、業界をリードしています。

MEMS

CMOSファンドリで量産可能なMEMSデバイスに特化し、当社はMEMSマイクロホンや高性能加速度センサ向けに、コスト効率に優れた独自の製造プラットフォームを開発してきました。今後も、拡大を続けるMEMS市場の多様なニーズに対応するため、機能をさらに強化し、プラットフォームの拡充を進めてまいります。



車載用途

当社の成熟したモジュール型プラットフォームは、電動化・自動運転車向けに包括的かつ先進的なアナログ技術ソリューションを提供します。

自動車市場では、常時接続(ユビキタス・コネクティビティ)、高度化する自動運転、そしてパワートレインの完全電動化が急速な成長を牽引しています。当社は市場をリードする企業とのパートナーシップを通じ、OEMやティア1サプライヤーからIDM、ファブレス企業に至るまで、幅広い自動車市場のお客様を支える最先端技術を開発しています。

当社の先進的なパワーマネジメントプラットフォームは、業界最小レベルのオン抵抗(R_{dson})と優れた電圧・電流処理性能を備え、モータードライバ、DC-DCコンバータ、バッテリーマネジメントIC、PMIC、ロードスイッチ、電圧レギュレータ、LEDドライバなど多様な用途に対応します。

CMOSイメージセンサ技術では、Time-of-Flight(ToF)測距、LEDフリッカー耐性、超低照度に対応する感度特性、サーマルイメージングなど、卓越した撮像性能を実現しています。グローバルシャッター(GS)技術は、ジェスチャーコントロールや乗客モニタリングといった高度なパターン投影用途に最適です。SPAD (Single Photon Avalanche Diode) はLiDARに適した優れた近赤外(NIR)撮像性能を提供します。

非イメージングセンサプラットフォームでは、環境・ヘルスケア・近接モニタリングなどの多様な用途に対応するターゲットセンサを展開しています。また、LCoS (Liquid Crystal on Silicon) 技術により、車内のあらゆる場所に次世代ディスプレイを実現します。

当社のRFおよび高性能SiGe技術は、車載レーダーにすでに大量採用されており、V2X、5G、衛星通信(Satcom)への展開も可能です。さらに、シリコンフォトニクス技術は、完全自動運転車やロボット向けの革新的でコンパクトなLiDARを実現します。

RFSOIやRFCMOSといった業界をリードするRF・アナログ技術に加え、世界各地のデザインセンターによるカスタム設計サービスやプロセス移管・最適化サービスを含む柔軟なファンドリ契約形態、IATF16949認証を取得した全製造拠点で卓越性を追求する強固な企業文化を持っており、当社は自動車分野をはじめとする多様な市場でシェアを拡大し続けています。進化を続ける自動車業界に向け、現在から次世代にわたる包括的な技術ソリューションを提供します。



航空宇宙・防衛分野

航空宇宙・防衛業界に向けた、幅広く高度な技術と商用ソリューションの提供
私たちは、航空宇宙・防衛分野 (A&Dコミュニティ) に対して、豊富な技術力と商用ベースの実績あるテクノロジーやサービスを提供しています

米国ニューポートビーチ工場を拠点に、航空宇宙・防衛分野の多様な企業と連携し、年々市場での存在感を高めています。

当社は、大量生産に対応した商用技術ポートフォリオを活用し、空宇宙・防衛業界に向けて、光信用シリコンフォトニクス、多様な赤外線(IR)アプリケーションやシステムに対応する大型フォーマットROIC(読み出し集積回路)、可視光イメージング、レーダ、無線、高速データ通信向けのSiGe BiCMOSデバイスのような高度で洗練されたソリューションを提供しています。

当社の製造施設はITAR認証を取得しており、信頼性の高いファンドリとして、米国政府の重要プロジェクトにも貢献しています。

ROIC分野では業界トップのファンドリとして認知されており、SiGe技術においても最先端を担っています。
さらに国防省(DoD)向け製造分野では、シリコンフォトニクス(SiPho)の新たなファンドリ能力を急速に拡大しています。

お客様のニーズと開発プロセスに応える豊富な技術基盤

- 光通信、センシング、新興市場における革新を支える業界最先端のシリコンフォトニクス技術
- ITAR対応の180nm、130nm、65nmプロセスによるROICおよびCIS(CMOSイメージセンサ)、ステイチング技術
- 航空宇宙・防衛分野に特化した技術チームと専任のプロジェクト管理体制
- タワーセミコンダクターの商用技術を活用した世界クラスの設計支援環境により、高効率かつ高精度な設計と初回シリコンでの成功を実現

当社は、航空宇宙・防衛分野における以下のような市場特有のアプリケーションに対応するため、さまざまな戦略的かつ専門的な取り組みを進めています。具体的には、無線およびミリ波通信、衛星通信、レーダー、高速データ通信、多様な赤外線および可視光イメージング、各種センサ、DAC、ADC、LNA、スイッチなどのカスタムアナログ回路、さらには光データ通信およびセンシング用途など、多岐にわたる技術分野に取り組んでいます。これらの技術を通じて、軍事・政府機関を中心とした幅広い顧客のニーズに応え、信頼と実績を積み重ねています。



研究開発

タワーセミコンダクターは、イノベーションと技術の進化をグローバルに推進しながら、家電、産業機器、無線通信、光通信・フォトニクス、自動車、医療、航空宇宙・防衛といった既存および新興のアナログエレクトロニクス市場に向けて、革新的なソリューションを備えた先進的な製造プラットフォームの開発を継続しています。近年の研究開発では、自動車向け先進運転支援システム(ADAS)、通信・モバイル用途に対応する高周波デバイス、RFスイッチ、スマートパワーマネジメント、新しいシリコンフォトニクスシステム、スマートCMOSイメージセンサおよび非イメージングセンサ、量子コンピューティング、データ処理向けのAI技術などの分野に注力しています。

これらの技術は、5G/6G、100G・400G・800G超のデータセンターネットワーク、高度なバッテリー制御とスマートパワー、産業・商業用センサ、航空宇宙・防衛といった新興市場における当社の取り組みを支える中核技術として位置づけられています。

新たな技術プラットフォーム、成果、革新的デバイスの創出

タワーセミコンダクターは、エンジニアによる独自の特許技術、お客様との緊密な連携、そして世界各地の主要な研究機関とのパートナーシップを通して、さまざまな研究開発活動を継続的に展開しています。

これらの取り組みは、業界の進化するニーズや製品ロードマップに対応する新たな製造プラットフォームや顧客ごとの専門的なソリューションの開発を目的としています。

継続的なイノベーションパートナーシップ

タワーは、米国、欧州、イスラエル、日本の世界的な学術機関と連携し、数多くの著名なコンソーシアムや共同研究プロジェクトに積極的に参加しています。

特許

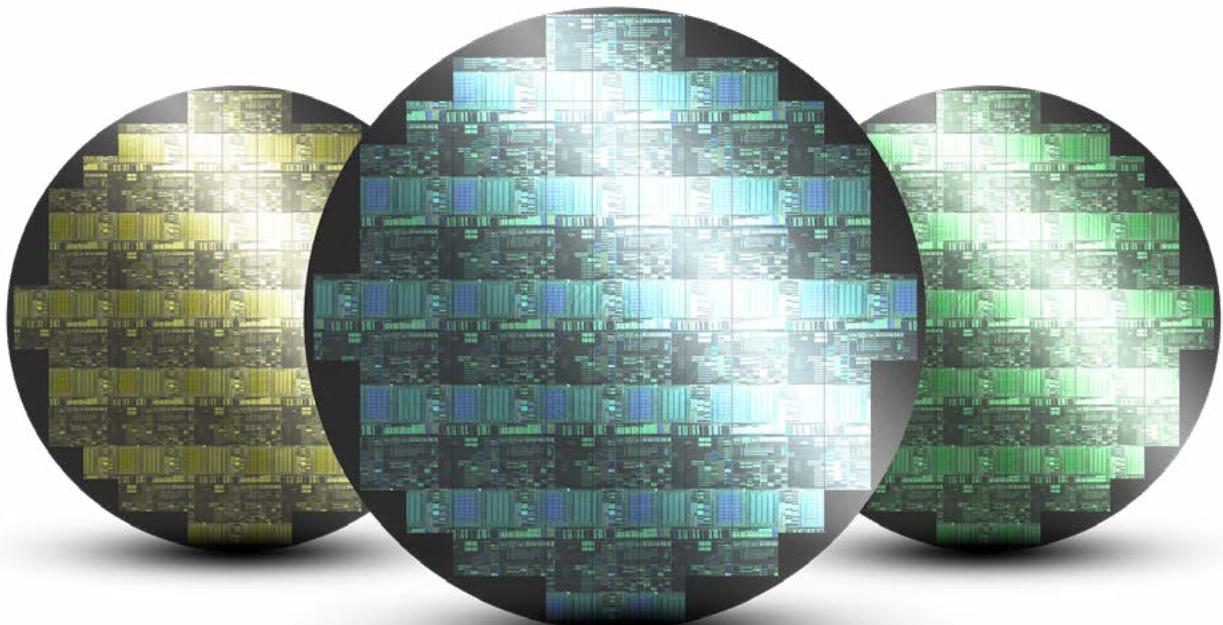
当社は毎年、多数の特許を出願・取得しています。これらの特許は、タワーの全ての事業分野にわたる技術力を反映しており、現在および将来の技術的フロンティアに向けた当社の取り組みを示すものです。

講演・論文発表

タワーセミコンダクターのエンジニアは、IEEE IMW、Electronics、IEEE EDなどの国際的な学会や専門誌において技術委員・学術委員や査読者としても活躍しています。また、毎年多数の技術論文が当社エンジニアによって発表されており、世界各地の主要な技術フォーラム、パネルディスカッション、学会において招待講演も行っています。



Where **Analog** and **Value** Meet



www.towersemi.com